

国際会議報告

Interfinish '88 に出席して

安谷屋 武志*

12th World Congress on Surface Finishing (別名 Interfinish '88) が昨年 (1988 年) 10 月 4~7 日の 4 日間フランスのパリで開催され、筆者も出席する機会を得たので会議の様相および印象を以下に述べてみたい。Interfinish とはその名も示すとおり表面処理全般に関する国際会議で、International Union for Electrodeposition and Metal Finishing が母体となり加盟各国の表面処理学協会が持ちまわりで、基本的には 4 年に 1 度オリンピックイヤーに行くことになっている。対象は鉄鋼のみならず、非鉄さらに最近では無機および有機材料の表面処理まで含まれる極めて幅広いものである。今大会は 12 回目であるが、過去 11 回の開催地および年次を表 1 に示した。1980 年秋に第 10 回大会が京都国際会議場で盛大に行われたことは、多くの方の記憶に新しいことと思われる。

今大会の概略は以下のとおり。まず会場はパリ市内北西部の Porte Maillot にある Palais des Congres (写真 1)。このビルにはホテル、デパート、テナントなどが同

表 1 Interfinish 開催年および場所

| 回 | 年 | 開催地 |
|----|------|---------|
| 1 | 1987 | ロンドン |
| 2 | 1939 | ニュールン |
| 3 | | ヨーク |
| 4 | | |
| 5 | 1959 | ロンドン |
| 6 | 1964 | トロント |
| 7 | 1968 | ロンドン |
| 8 | 1972 | ハーゼルム |
| 9 | 1976 | アムステルダム |
| 10 | 1980 | 京都 |
| 11 | 1984 | エルサレム |
| 12 | 1988 | パリ |

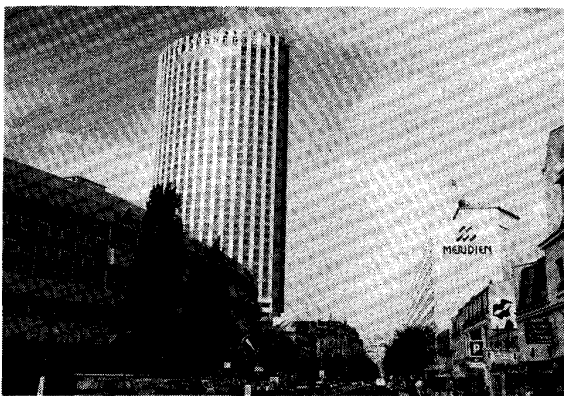


写真 1 Interfinish の会場

居するほか、各種イベントが行われるいわゆる多目的ビルである。このビルの 5 階で行われた。3 会場で約 1000 人ぐらいの収容能力。出席者総数は約 800 人。うち約 7 割が地元フランス人。日本からは約 50 人でフランス、ドイツに次ぐ数であった。日本からの出席者は表面技術協会関係の人が大半であったが、鉄鋼関係でも新日鉄、住金および筆者の属する NKK などから出席者があつた。

発表総件数は約 120 件。3 会場で 18 セッション、延べ 4 日間で行われた。主な分野別発表件数は次のとおり。

- (1) 高速めつき 3 件
- (2) 合金めつき 9 件
- (3) パルス電解めつき 10 件
- (4) 複合・分散めつき 10 件
- (5) 無電解めつき 9 件
- (6) 化成処理, 有機皮覆 9 件
- (7) CVD, PVD 15 件
- (8) 腐食, 環境 16 件

公用語はフランス語と英語で、Proceedings および Presentation とともにこの 2 か国語のみで、相互の同時通訳がついている。

鉄鋼の表面処理関係者に関心があると思われる発表項目には次のようなものがあつた。高速めつき関係で、Radical jet cell, Belt cell, Flash cell などを用いた高電流密度電解, Laser 照射電気めつきなど。合金めつきでは、Mo-Cr-Fe 系合金めつき, Zn-Ni 系バレルめつき, 亜鉛系合金めつきの腐食挙動, Zn-Mn 合金めつきの構造, Ni-Cu 合金めつきなど。また、パルスめつきでは、電解パターンとめつき層構造および性質に関するもの、合金、複合、複層化技術に関するものが数件ずつあつた。複合・分散めつき関係では、耐摩耗・潤滑皮膜、熱バリア皮膜、析出メカニズムに関するものなど。化成処理、有機皮覆関係では、りん酸塩処理における前処理の影響、りん比と耐食性、電子線硬化、1 液タイプのクロム酸-有機樹脂塗布鋼板などの発表があつた。今大会全体を通して最も活況を呈したセッションは、パルス電解と分散・複合めつきであり、日本の関連学協会での発表と比べても、この分野の発表が最も印象的であつた。

会期中のイベントとして、2 日目夜のパリ市庁舎におけるシラク市長主催のカクテルパーティー (写真 2)、3 日目夜のパリ名所ムールンージュにおける晩さん会があり、参加者達は大変楽しい一時を持った。特にムールンージュの晩さん会にはびつくりした。昼は毎日大レストランで一諸にランチを食べるようになっており、ここでも交流の場をつくってくれた。

次に本大会の印象を述べる。まず、参加登録費が 5000 FF (約 11 万円) と非常に高かつたこと。晩さん会、昼食会などにお金を掛けたためであろう。円高の日

* NKK 商品技術センター 工博



写真 2 バリ市庁舎における歓迎レセプション

本人でさえ気が重かったが、あれだけ多くの外国人によく出せたと思う。次に言葉の問題で、先述のとおり公用語は英、仏であつたが、仏語→英語の同時通訳が極めて聴き取りにくく（大半が仏語の話すスピードに追いついていない）、テキストはもちろん仏語で書かれているため、全くのお手あげという状態であつた。フランス人以外は全員そう思つたに違いないが、特に我々日本人にとっては英語一本にしてもらつた方がはるかに理解しやすかつた。それから Proceedings のボリュームにも閉口した。何しろ部厚い電話台帳分 3 冊である。それも日時順に並べておいてくればまだ良いが、分野、会場などを考慮して複雑な並べ方をしているため常に 3 冊持つ

て歩かなければならなくなつている。もつとも 2 日目以降はあきらめて 1 冊も持たずに来る人もかなり見受けられた。京都大会でもほぼ同数の発表論文があつたが、1 件 4 頁以下に限定したため 1 冊で済んだ。いずれにしても論文の執筆要領、編集方法に一工夫ほしかつた。大会の運営はたいへん円滑に行われていた。私が今大会で最もユニークでかつ有意義だと思つた企画は先述の全員ランチョンである。広いホールに円卓(10~15 人掛け)が多数並べられており、長い昼食を楽しむというもの。旧交を温めるとか情報交換には最もよい機会であつた。ただ登録者数の割には日本人の参加者が極めて少なかつたのは残念であつた。花のバリでの開催ということもあり、社会見学に繰り出している人がかなり目立つた。

次回大会は 1992 年ブラジルで開催される予定である。また日本からも多数の参加者があるものと思われるが、筆者のこれまで 3 回(アムステルダム、京都、パリ)の出席経験からすると、発表テーマは深く高度なものよりレビュー主体で幅の広い話の方が聴衆受けすると思われる。というのはこの大会は 4 年に 1 度のお祭りの要素が強いから。従つて発表者も新進の研究者より、幅広く話のできる室長クラスの人が望ましいと思う。

それでは最後にこれからの Interfinish で、日本から話題をさらうような優れた発表がなされることを期待しつつ筆を置きます。